

公司代码：603005

公司简称：晶方科技

**苏州晶方半导体科技股份有限公司**  
**2023 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年度公司的利润分配方案为：以公司目前总股本652,615,226股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46（含税），共计人民币30,020,300.40元。

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	吉冰沁
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

### 2 报告期公司主要业务简介

公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、

汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。

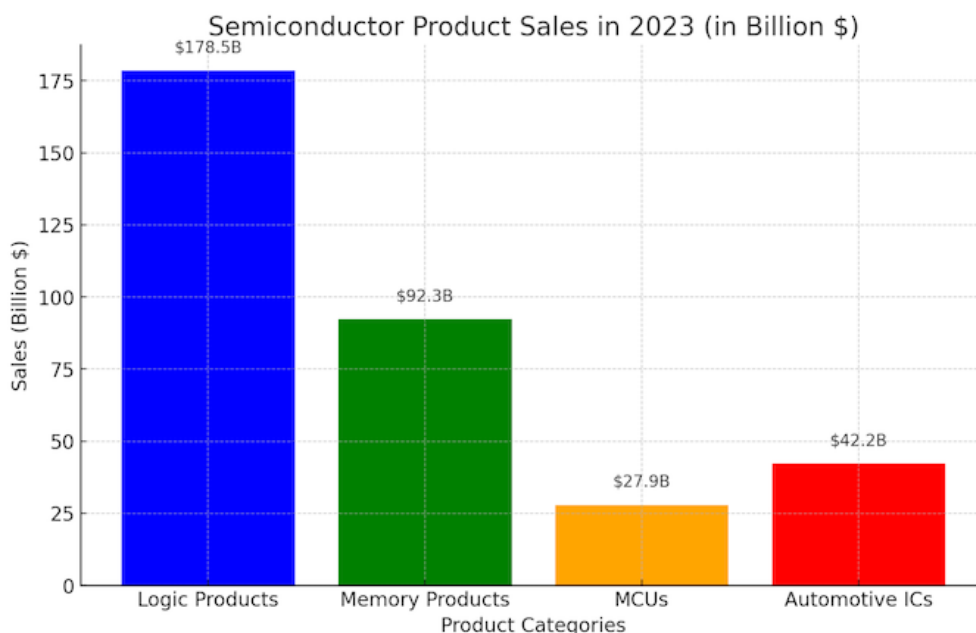
### （一）半导体整体市场情况

根据美国半导体行业协会（SIA）发布数据显示，2023 年全球半导体行业销售额总计 5,268 亿美元，较 2022 年 5,741 亿美元的销售额下降 8.2%。从季度趋势上看 2023 年下半年销售额有所回升，其中第四季度销售额为 1,460 亿美元，比 2022 年第四季度增长 11.6%，比 2023 年第三季度增长 8.4%。2023 年 12 月的销售额为 486 亿美元，较 2023 年 11 月总额增长 1.5%。

从地区分布来看，欧洲是半导体行业唯一一个在 2023 年实现年度增长的区域市场，销售额增长了 4.0%，除此之外全球其他区域市场的年销售额均有所下降：日本(-3.1%)、美洲(-5.2%)、亚太/所有其他市场(-10.1%)和中国(-14.0%)。与 2023 年 11 月相比，2023 年 12 月的销售额在中国(4.7%)、美洲(1.8%)和亚太/所有其他地区(0.3%)有所增长，但在日本(-2.4%)和欧洲(-3.9%)有所下降。

从细分行业来看，逻辑产品的销售额在 2023 年总计达 1,785 亿美元，使其成为销售额最大的产品类别。内存产品的销售额位居第二，总计 923 亿美元。微控制器单元(MCU)增长 11.4%，达到 279 亿美元。汽车 IC 销售额同比增长 23.7%，达到创纪录的 422 亿美元。

图一、全球半导体行业 2023 年销售额



数据来源：美国半导体行业协会

### （二）公司所处细分市场情况

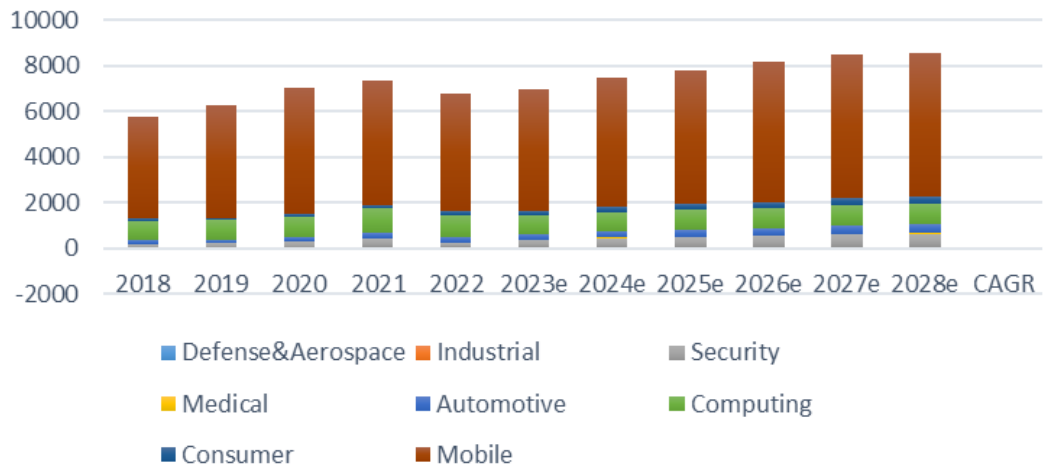
#### 1、传感器市场

公司专注于集成电路先进封装技术，拥有领先的硅通孔（TSV）、晶圆级、Fanout、系统级等多样化的封装技术，具备为客户构建完整的传感器芯片的异质集成能力，聚焦于以影像传感芯片为代表的传感器领域，封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用在智能手机、安防监控数码、汽车电子、身份识别等市场领域。

根据研究机构 YOLE 在 2023 年发布的报告，从全球 CIS 出货量来看，2022 年出货量为 68 亿颗，预计 2028 年将增长到 86 亿颗，年复合增长率为 4%；从全球 CIS 市场收入来看，2022 年总收入为 213 亿美元，预计 2028 年将增长到 288 亿美元，年复合增长率为 5.1%，相关增长的驱动主要来自智能手机、汽车电子、安防监控以及计算机等相关市场。

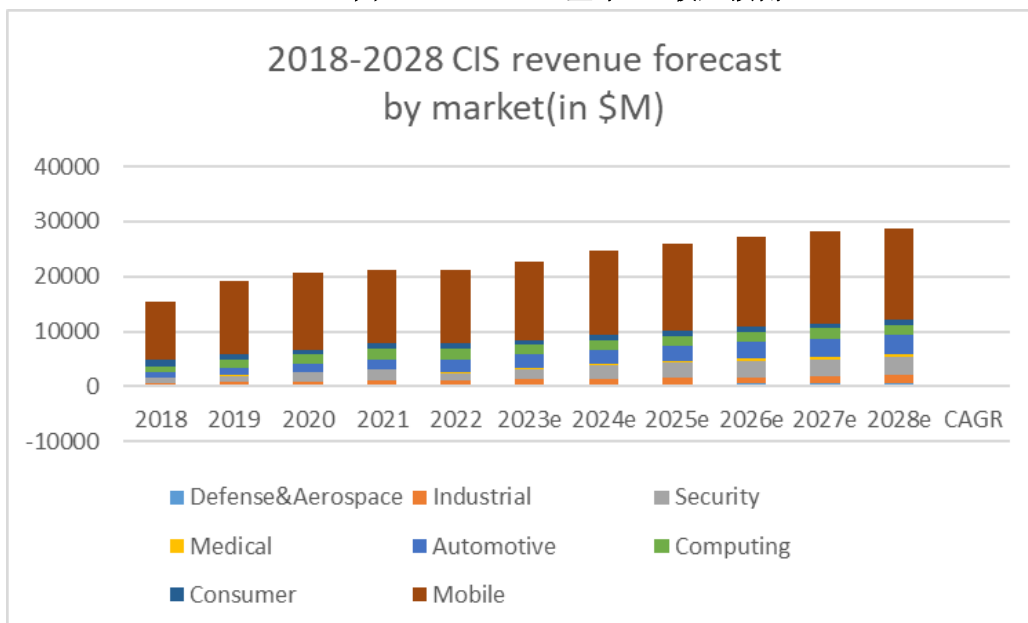
图二、2018-2028 全球 CIS 出货量预测

## 2028-2028 CIS volume shipment forecast by market(in munits)



数据来源：YOLE

图三、2018-2028 全球 CIS 收入预测



	2018	2019	2020	2021	2022	2023e	2024e	2025e	2026e	2027e	2028e	CAGR
Defense&Aerospace	211	224	293	382	375	407	450	492	535	590	651	9.6%
Industrial	435	561	600	698	865	919	987	1089	1192	1302	1391	8.2%
Security	941	1201	1636	1965	1241	1886	2374	2703	2962	3076	3280	17.6%
Medical	39	88	112	106	256	284	315	352	389	423	458	10.2%
Automotive	899	1274	1412	1712	2186	2389	2579	2789	3099	3376	3627	8.8%
Computing	1200	1516	1745	2029	1968	1648	1781	1748	1738	1799	1748	-2.0%
Consumer	1125	995	794	955	902	901	908	902	895	890	882	-0.4%
Mobile	10574	13401	14068	13441	13452	14332	15378	15863	16444	16870	16720	3.7%
Total	15478	19323	20743	21328	21292	22765	24772	25939	27255	28325	28758	5.1%
YOY(%)	11.3%	24.8%	7.3%	2.8%	-0.2%	6.9%	8.8%	4.7%	5.1%	3.9%	1.5%	
Previous forecast 2022	15478	19329	20743	21328	23366	25313	27327	28896	30433	31441		

数据来源：YOLE

## 2、光学器件市场

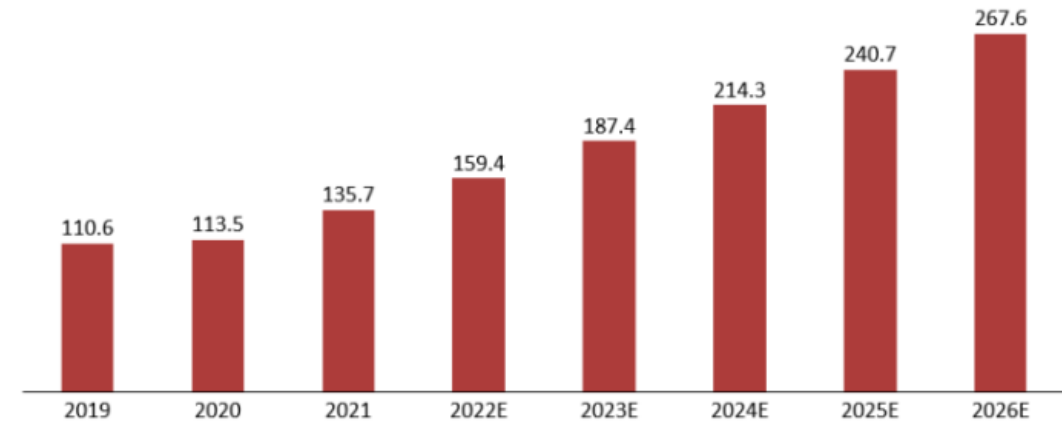
精密光学产品作为视觉成像系统或其核心部件发展迅速，其应用范围不仅包括照相机、望远镜、显微镜等传统光学产品，近年来消费级精密光学作为智能手机、安防监控摄像头、车载摄像头等产品的核心部件，成为影响终端产品应用效果的重要因素；与此同时工业级精密光学在工业测量、激光雷达、航空航天、生命科学、半导体、AR/VR 检测等新兴领域的应用与市场规模也在迅速提升。根据华经产业研究院的资料，2022 年全球精密光学元器件行业市场规模约为 446.8 亿美元，分区域看，亚太是全球精密光学元器件最大的市场，2022 年亚太精密光学元器件市场规模占总规模比重达 42.77%，其次为北美和欧洲地区。

随着半导体、工业量测、智能驾驶等应用领域的发展，工业级精密光学市场将迎来广阔发展空间，根据弗若斯特沙利文发布的报告，工业级精密光学市场从 2019 年的 110.6 亿人民币增长到

2021 年的 135.7 亿人民币，年均复合增长率达到 10.8%。且根据弗若斯特沙利文预测，全球工业级精密光学市场规模将从 2022 年的 159.4 亿人民币增长到 2026 年的 267.6 亿人民币，年均复合增长率为 13.8%。

图四、全球工业级精密光学市场规模预测

(单位：亿人民币)



数据来源：弗若斯特沙利文

#### (一) 主营业务

公司主要专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装线，涵盖晶圆级到芯片级的一站式综合封装服务能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片等，该等产品广泛应用在手机、安防监控、身份识别、汽车电子、3D 传感等电子领域。同时，公司通过并购及业务技术整合，有效拓展微型光学器件的设计、研发与制造业务，并拥有一站式的光学器件设计与研发，完整的晶圆级光学微型器件核心制造能力，相关产品广泛应用在半导体设备、工业智能、车用智能投射等应用领域。

#### (二) 经营模式

公司所处封装行业的经营模式主要分为两大类：一类是 IDM 模式，由 IDM 公司设立的全资或控股的封装厂，作为集团的一个生产环节，实行内部结算，不独立对外经营；另一类是专业代工模式，专业的封测企业独立对外经营，接受芯片设计或制造企业的订单，为其提供专业的封装服务，按封装量收取封装加工费。

公司为专业的封测服务提供商，经营模式为客户提供晶圆或芯片委托封装，公司根据客户订单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，公司自行采购原辅材料，由生产部门按照技术标准组织芯片封装与测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收取封装测试加工费。对于公司拓展的微型光学器件业务，公司根据客户的需求，进行光学器件的设计、研发，自行采购原辅材料，由生产部门按照设计参数与技术工艺标准进行生产制造，完工检验后将光学器件出售给客户，并向客户收取产品销售货款，公司与客户签署产品销售合同，约定产品采购数量、销售单价等事项。

销售方面，公司主要向芯片设计公司提供封装、测试和封测方案设计服务。芯片设计公司主要负责芯片电路功能设计与芯片产品的销售。芯片设计公司完成芯片设计，交给晶圆代工厂（Foundry）制造晶圆芯片，晶圆芯片完工后交付公司，由公司组织进行芯片封装、测试，公司与客户建立合作关系时，签署委托加工框架合同，客户定期发送加工订单确定加工数量、价格等事

项。对于微型光学器件业务，公司根据客户的需求进行光学器件产品的设计、开发与生产，并向客户进行产品销售出货，公司与客户建立合作关系时，双方签署采购订单或合同，约定产品的采购数量、价格等。

采购方面，公司采购部直接向国内外供应商采购生产所需原辅材料。具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合格后仓库入库并由生产领用。公司与供应商建立了长期的合作关系，根据市场状况决定交易价格。

### （三）公司所处产业链环节

公司封装业务所处产业链主要包括芯片设计、晶圆制造与封装测试几个产业环节，同时还涉及相关材料与设备等支撑产业环节。产业以芯片设计为主导，由芯片设计公司设计出集成电路，然后委托芯片制造厂生产晶圆，再委托封装厂进行芯片的封装、测试，最后销售给电子整机产品生产企业。对本公司而言，芯片设计企业委托公司进行封装加工，是公司的客户；材料等支撑企业为公司提供生产所需的原材料，是公司的供应商。

公司光学器件业务上游主要为光学原材料制造，参与者主要为生产光学玻璃的材料企业；中游为光学元件及其组件，是将光学玻璃通过精密加工，生产成光学元件及镜头等产品的环节；下游主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	4,824,122,558.00	4,582,443,930.84	5.27	4,457,831,264.15
归属于上市公司股东的净资产	4,088,742,566.33	3,986,719,578.53	2.56	3,852,578,360.30
营业收入	913,288,878.20	1,106,070,998.70	-17.43	1,411,173,857.40
归属于上市公司股东的净利润	150,095,690.43	228,443,950.74	-34.30	576,877,345.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,945,279.82	204,423,836.72	-43.28	472,126,289.57
经营活动产生的现金流量净额	305,581,902.42	391,750,297.78	-22.00	613,101,286.33
加权平均净资产收益率(%)	3.72	5.86	减少2.14个百分点	15.92
基本每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.88
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.35	-34.29	0.88

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	223,213,535.29	258,548,098.53	199,950,901.91	231,576,342.47
归属于上市公司股东的净利润	28,566,647.32	48,044,734.81	34,060,412.42	39,423,895.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,425,738.98	38,818,197.09	26,054,036.10	30,647,307.65
经营活动产生的现金流量净额	18,366,146.13	111,934,399.71	75,574,898.70	99,706,457.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					139,385		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					134,342		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中新苏州工业园区创业投资有限公司	-15,120,000	115,849,766	17.75		无		国有法人
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,859,920	8,827,934	1.35		未知		未知
香港中央结算有限公司	2,300,124	6,404,474	0.98		未知		未知
余巧英	6,027,044	6,027,044	0.92		未知		未知
上海浦东发展银行股	5,743,464	5,743,464	0.88		未知		未知



份有限公司—景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金							
孙小明	0	4,022,464	0.62		未知		未知
曹琼	3,342,360	3,342,360	0.51		未知		未知
上海韦尔半导体股份有限公司	0	3,320,075	0.51		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—金鹰科技创新股票型证券投资基金	2,170,096	2,170,096	0.33		未知		未知
交通银行股份有限公司—金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	1,970,000	1,970,000	0.30		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司专注于集成电路先进封装技术的开发与服务，聚焦于传感器领域，封装的产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、MEMS 芯片等，相关产品广泛应用在智能手机、AIOT（安防监控数码等）、汽车电子、身份识别等市场领域。2023 年由于受全球经济发展下行，市场需求下降、行业去库存压力等多因素影响，公司所专注的影像传感器细分市场景气度疲软，虽然公司在手机、安防等领域的市场占有率稳固提升，在汽车领域的量产规模持续提升，但业务规模与盈利能力仍然受到手机等消费类电子市场不景气及行业去库存压力的相关影响，报告期内，公司实现销售收入 91,328.89 万元，同比下降 17.43%，实现营业利润 16,102.35 万元，同比下降 37.59%，

实现归属于上市公司股东的净利润 15,009.57 万元，同比下降 34.30%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用